

招商证券股份有限公司

关于深圳市强达电路股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）



住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

深圳证券交易所：

作为深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”、“强达电路”、“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市保荐书内容与格式指引》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

在本上市保荐书中，除非另有说明，所用简称与《深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》保持一致。

目 录

一、发行人概况	4
（一）发行人简介	4
（二）发行人的主营业务	4
（三）核心技术	7
（四）研发水平	13
（五）主要经营和财务数据及指标	15
（六）发行人存在的主要风险	17
二、本次发行情况	24
（一）本次发行的基本情况	24
（二）本次发行上市的重要日期	25
三、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍	26
（一）保荐机构名称	26
（二）保荐代表人主要保荐业务执业情况	26
（三）项目协办人及其他项目组成员	27
四、保荐机构与发行人之间的关联关系	27
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次 发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况	27
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股 东、实际控制人、重要关联方股份的情况	27
（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员拥有发行人 权益、在发行人任职等情况	27
（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际 控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况	27
（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系	28
五、保荐机构的承诺	28
六、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》、中国证监会和	

深圳证券交易所规定的决策程序	29
（一）发行人董事会对本次证券发行上市的批准.....	29
（二）发行人股东大会对本次证券发行上市的批准、授权.....	29
七、保荐机构关于发行人符合创业板上市条件的说明	29
（一）发行人符合《注册管理办法》有关规定.....	29
（二）发行人符合《创业板上市规则》有关规定.....	32
八、对公司持续督导期间的工作安排	33
九、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式	34
十、保荐机构认为应当说明的其他事项	35
十一、保荐机构对本次股票上市的推荐结论	35

一、发行人概况

（一）发行人简介

发行人名称	深圳市强达电路股份有限公司
英文名称	Shenzhen Q&D Circuits Co., Ltd.
注册资本	5,653.18 万元
法定代表人	祝小华
成立日期	2004 年 5 月 31 日
整体变更设立日期	2021 年 7 月 27 日
公司住所	深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路 3 号福发工业园 A-1 栋厂房 101-401
邮政编码	518103
联系电话	0755-29919816
传真号码	0755-29919826
互联网网址	https://www.qdcircuits.com
电子邮箱	ir@qdcircuits.com
经营范围	一般经营项目是：印制线路板、印刷线路板装配件、印制线路板材料及化工产品(危险化学品除外)、印制线路板设备的设计、技术开发、销售;电子元器件的销售；线路板及其元器件的技术咨询、技术服务;企业管理咨询（不含人才中介服务）；机器设备租赁(不含融资租赁及其他限制项目);国内外贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止和限制项目除外），许可经营项目是：印制线路板、印刷线路板装配件、印制线路板材料及化工产品(危险化学品除外)、印制线路板设备的生产、加工；电子元器件的生产；电子元器件的贴组装、测试。
负责信息披露和投资者关系的部门	证券部
负责信息披露和投资者关系的负责人及联系方式	董事会秘书：周剑青 联系方式：0755-29919816

（二）发行人的主营业务

公司深耕 PCB 行业近二十年，主营业务为 PCB 的研发、生产和销售，是一家专注于中高端样板和小批量板的 PCB 企业。公司凭借快速响应、柔性制造和

优异的服务水平，致力于满足客户电子产品在研究、开发、试验和小批量阶段对 PCB 的专业需求，产品广泛应用于工业控制、通信设备、汽车电子、消费电子、医疗健康和半导体测试等应用领域。

公司 2004 年创立于深圳，抓住国内 PCB 行业早期缺少中高端样板产能的市场机遇快速发展。公司通过多年积累，不断改进管理方式和生产工艺，建立起适合于中高端样板和小批量板的柔性化管理和生产制造产线。2018 年 3 月，随着江西工厂投产，经过两年时间的产能爬坡和工艺磨合，以及深圳工厂的生产订单转移和产品定位调整，公司逐渐提升生产效率、突破产线混合和产能瓶颈的限制，现有产能扩张至 51.71 万平方米，产品型号增加和产品层数提高。深圳工厂主要定位为中高端样板和部分特殊工艺或特殊材料的批量板，江西工厂主要定位为快速交付的批量板。2019 年以来，在产业政策支持和行业快速发展的推动下，公司成长为聚焦中高端样板和小批量板业务，并在样板市场具有领先地位的 PCB 企业。2021 年 12 月，公司设立全资子公司南通强达作为本次募投项目的实施主体，募投项目建成后，未来公司高多层板和 HDI 板等中高端产能将进一步提升。

公司 PCB 产品按订单面积分为样板、小批量板和大批量板，按产品层数分类为单/双面板和多层板。2021 年，公司样板、小批量板和大批量板占 PCB 产品收入的比例分别为 39.40%、38.14%和 22.46%；单/双面板和多层板占 PCB 产品收入的比例分别为 22.69%和 77.31%。公司覆盖的客户领域众多、产品应用领域广泛，在与客户的合作过程中，形成了大量涵盖特殊工艺或特殊材料的中高端 PCB 工艺制程能力，打造了丰富的定制化 PCB 产品体系。公司特殊工艺或特殊材料的中高端 PCB 产品主要包括：高多层板、高频板、高速板、HDI 板、厚铜板、刚挠结合板、半导体测试板和毫米波雷达板等。

公司订单呈现“多品种、小批量、高品质、快速交付”的需求特点。2021 年，公司销售的 PCB 型号超过 8 万种，平均订单面积 3.88 平方米，其中样板和小批量板的平均订单面积分别为 0.83 平方米和 13.68 平方米。公司 PCB 产品可实现快速交付，单/双面板最快可 24 小时内交付，多层板最快可 48 小时内交付。2021 年，公司 PCB 产品交付周期一般为 5-10 天，其中样板和小批量板的平均交付周期分别约为 5 天和 8 天，公司交付周期快于业内平均水平。

公司创始团队成员来自于深南电路、崇达技术等 PCB 业内优质上市公司，具有二十年以上 PCB 产品的研发、设计、生产、销售和管理经验。公司现有管理团队和研发团队长期稳定，在中高端样板和小批量板的专业领域积累了深厚的管理经验和研发经验。同时，公司在技术中心、工艺部、工程部和品质部等研发相关部门的通力协作下，形成多项中高端 PCB 产品专利技术或专有技术。

公司是高新技术企业、中国电子电路行业协会（CPCA）协会会员单位和深圳市线路板行业协会（SPCA）监事单位，公司全资子公司江西强达是高新技术企业和江西省“专精特新”中小企业。2019-2021 年，公司连续三年被中国电子电路行业协会评为中国电子电路行业百强企业，其中 2019-2021 年公司在综合 PCB 企业中排名分别为第 100 位、第 89 位和第 84 位，在内资 PCB 企业排名分别为第 60 位、第 56 位和第 51 位，公司排名逐年提升。此外，公司 2021 年作为“快板/样板”企业入选中国电子电路行业协会评选的“特色产品主要企业”十大企业榜单。

公司长期聚焦于中高端样板和小批量板市场，在与不同领域的众多客户合作中形成 PCB 工艺制程能力。公司 PCB 主要制程能力达到行业主流水平，产品最高层数可达 50 层，内层最小线宽/线距最小为 2.0mil/2.0mil，外层最小线宽/线距最小为 3.0mil/3.0mil，机械钻孔最小孔径为 4.0mil，激光钻孔最小孔径为 3.5mil，最大厚径比为 20:1，最大铜厚为 30 盎司。公司自主研发的“77GHz 毫米波雷达 PCB 关键技术及产业化”项目已通过科学技术成果评价，达到国内领先水平。

报告期内，公司服务的活跃客户近 3,000 家，主要客户有上市公司近百家公司，公司与客户关系长期稳定，报告期内老客户贡献了 95% 的订单收入。客户主要包括电子产品制造商、PCB 贸易商和 PCB 生产商，均具备 PCB 行业专业的生产、制造或贸易经验。公司与大多数主要客户具有近十年的合作关系，长期稳定的客户资源为公司业绩增长和未来发展奠定了坚实的基础。公司客户中，电子产品制造商主要包括大富科技（300134.SZ）、华兴源创（688001.SH）、Scanfil（斯凯菲尔）、Phoenix（菲尼克斯）、一博科技、汇川技术（300124.SZ）、春兴精工（002547.SZ）和武汉凡谷（002194.SZ）等客户，PCB 贸易商主要包括 Fineline、PCB Connect（科恩耐特）和 ICAPE（艾佳普）等客户，PCB 生产商主要包括 W

ürth（伍尔特）和 HT Global Circuits 等客户。

公司 PCB 产品销售区域广泛，境内销售与境外销售共同发展。2021 年，公司境内销售和境外销售占 PCB 产品收入的比例分别为 59.15%和 40.85%。公司境内销售集中在华东区域、华南区域和华北区域等，该等区域占境内 PCB 产品销售收入的比例为 83.27%；境外销售以欧洲区域为主，欧洲区域占境外 PCB 产品销售收入的比例为 68.67%。

（三）核心技术

自成立以来，公司一直专注于中高端样板和小批量 PCB 生产制造，坚持自主研发。基于优秀的技术研发团队和公司的技术创新能力，以及近二十年来在中高端样板和小批量板领域生产工艺技术的开发经验，公司在高多层、超厚铜、HDI 板、高频高速板、特种板和其他特殊加工等工艺技术方面具备深厚的积累，形成多项核心技术。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已形成的主要核心技术如下：

技术类别	核心技术名称	专利号/专有技术	技术来源	应用情况	核心技术特点
高多层板	超高层工艺	ZL202011126109.1 ZL201910642638.8	自主研发	样板：8-50 层 批量板：8-30 层	1、公司高多层板的最高层数可达 50 层，内层孔到线 7mil，通过真空蚀刻技术、激光直接成像技术，实现更高精度的线宽，同时通过工艺改进提高多层板的生产效率。 2、公司高多层和超高多层工艺已形成“一种多层 PCB 高精度内层压合方法”和“一种多层印刷电路板加工用铆合夹接装置及其工作方法”等发明专利。 3、公司高多层板核心技术，解决线路板间涨缩系数的匹配及生产参数的制定，多张芯板压合层间对准度，提高钻孔加工能力及钻孔参数收集，解决高厚径比电镀镀孔问题。
	超高厚径比 钻孔工艺	ZL 201920236203.9	自主研发	样板 25:1-40:1 小批量板 16:1-25:1 大批量板<16:1	
	电镀工艺	ZL202120244055.2	自主研发	样板和批量板	
	镀孔工艺	ZL 202021192460.6	自主研发	样板和批量板	
厚铜板	超厚铜板件 工艺	ZL 201920198575.7	自主研发	样板 30 盎司 批量板 12 盎司	1、公司铜厚可达 30 盎司，阻值公差样板和小批量板可实现小于 10%，铜厚均匀性控制在 $\pm 3\mu\text{m}$ 以内。 2、公司将双面板中的铜厚分开制作，线路制作完成后将其压合，并进行钻孔、沉铜、图形转移等正常工序，可降低超厚铜板蚀刻难度，提高铜厚均匀度。
	线圈阻值板 工艺	ZL202021820833.X	自主研发	样板和小批量板< 10% 大批量板 $\geq 10\%$	
高密度互连板(HDI 板)	多阶高密度 互连板工艺	ZL202021193845.4 ZL201920208821.2	自主研发	样板：任意 1-6 阶 批量板：任意 1-4 阶	1、公司利用高均匀性能力垂直连续电镀设备（VCP）以及高解析度曝光机和干膜，实现最小线宽/线距为 2mil/2mil，铜厚均匀性控制保证 R 值在 $5\mu\text{m}$ 以内，成品孔径为 0.075mm，以及最高实现 6 阶任意互连。 2、公司高密度互连板技术通过曝光机对位保证图形对位精准，精度控制在 $10\mu\text{m}$ 以内，压合采用融合加铆合以提高层压对准度，激
	电镀填孔工 艺	ZL202021192460.6	自主研发	样板和批量板	

技术类别	核心技术名称	专利号/专有技术	技术来源	应用情况	核心技术特点
	多次压合盲埋孔工艺	ZL202021193845.4	自主研发	样板和批量板	光打孔测试调整比例，达到叠孔一致性，电镀填孔凹陷度控制在15μm 以内。 3、公司“树脂塞孔 PCB 板除胶打磨台”实用新型专利已授权；公司申请的“一种免打磨的树脂塞孔 PCB 板制作工艺”发明专利已进入实质审查阶段，可减少树脂塞孔生产过程中的树脂打磨流程，减少因打磨造成的品质问题，有效提升树脂塞孔工艺的效率。
	树脂塞孔工艺	ZL202020824485.7	自主研发	样板和批量板	
高频板 高速板	毫米波印制板工艺	ZL202110615726.6 (申请中)	自主研发	样板和批量板	1、汽车电子高级驾驶辅助系统(ADAS)市场规模快速提升，77GHz 和 79GHz 车载毫米波雷达仍属于初级阶段，公司已实现 77GHz 毫米波雷达 PCB 生产，“77GHz 毫米波雷达 PCB 关键技术及产业化”项目通过科技成果鉴定，已达到国内领先水平。 2、公司 77GHz 毫米波雷达板采用薄化相阵天线，有利于减小天线辐射损耗，形成窄波束；优先采用 18$\pm$3μm 天线铜厚控制；焊盘拐角采用特殊设计，改进钝化长度有利于提高天线增益、抑制频漂和形成雷达窄波束；天线位置局部薄铜设计，一旦 EA 值超出要求就会影响无线信号的传输和接收，严重情况下将出现信号增益的问题，方盘拐角 EA 值$\leq$10μm；实际控制在 EA 值$<$8μm。 3、公司申请的“一种局部薄铜印制电路板制作方法”发明专利已进入实质审查阶段，降低 PCB 损耗，提高了制作过程的良率，降低生产成本。
	高频印制板工艺	ZL201510691253.2	自主研发	样板和批量板	

技术类别	核心技术名称	专利号/专有技术	技术来源	应用情况	核心技术特点
	背钻工艺	ZL201920236203.9	自主研发	样板和批量板	1、公司高多层背板电镀后直接整板镀锡，在镀锡后进行背钻，通过蚀刻解决铜丝问题，蚀刻后树脂塞孔，将背钻塞孔镀平，解决高多层背板层间结构的设计，使得孔深钻深度公差控制在$\pm 0.1\text{mm}$以内，有效避免高速信号在 PCB 线路传输的反射、散射、延迟等，增长高速板性能。 2、公司申请的“一种背板阻焊制作方法”的发明专利已进入实质审查阶段，该方法可以有效解决油墨入孔问题，提高背板良率，降低生产成本。
特种板	台阶印制板工艺	ZL201920773066.2	自主研发	样板和批量板	1、公司通过正、反锣槽的方式为台阶“揭盖”；增加对微盲孔采用等离子体清洗，等离子体可将钻孔后所残留的碳黑清洗干净，减少回流焊后盲孔脱垫。 2、公司“一种台阶印制电路板”实用新型专利已获授权，“一种台阶印制电路板及其制作方法”发明专利已进入实质审查阶段，该制作方法有效防止层压溢胶污染台阶底部金属线路，可减少后期除胶难度。
	多张软板的刚挠结合板工艺	ZL201210452502.9	自主研发	样板和批量板	1、公司将玻璃树脂粘结片和半固化片分别加热到 180°C，再将两者进行压合，得到两面性粘结片，有效弥补了刚挠结合板的结合强度不足与流胶不规律的缺陷，使刚挠结合板具有完美的抗高温热冲击能力与恶劣环境下的稳定使用效果。 2、公司已获得“用于软硬结合板的两面性粘结片及其制作方法”发明专利的授权。
	镶嵌板工艺	ZL201920198575.7	自主研发	样板和批量板	1、公司获得的“一种可快速散热的多层印制 PCB 线路板”实用新型

技术类别	核心技术名称	专利号/专有技术	技术来源	应用情况	核心技术特点
		ZL202021820833.X			专利，通过第一线路层、第一导热板、印刷保护框、冷却输入管和固定框，解决了多层 PCB 散热效率低、散热不完全和缺少对线路板边角走线的保护问题。 2、公司获得的“一种用于定位铜基 PCB 板压合的工装及 PCB 板”实用新型专利，通过第一销钉定位孔和第二销钉定位孔，提高定位效果。
	陶瓷板	ZL201510691253.2	自主研发	样板和批量板	1、公司已在陶瓷 PCB 方面取得“一种小尺寸、薄纯陶瓷线路板的加工方法”发明专利，该项方法制作陶瓷 PCB 的优点是通过压合溢胶（镶嵌）的方式，形成大的拼板，解决小尺寸、薄纯陶瓷 PCB 加工过程中的易碎性问题，提高工艺效率。 2、公司针对“陶瓷混压 HDI 印制板”进行研发，以实现陶瓷混压钻孔及孔金属化工艺，提高陶瓷混压板工艺流程和成品效率。
特殊工艺	局部电金工艺	ZL201921164327.7 ZL202110615185.7 （申请中）	自主研发	样板和批量板	局部电厚金高密度互连板性能优异，但市场上广泛制作的局部电厚金 PCB 金厚一般在 1.0 μ m 以下，公司研发利用高效率的电厚金药水实现金厚 1.0-2.5 μ m，保证最小金厚 1.0 μ m，金厚均匀性保证在 70%以上。
	阶梯结构金手指工艺	ZL201921164327.7	自主研发	样板	公司金手指工艺技术上研发出一种阶梯结构金手指工艺，“一种阶梯结构金手指的制作方法”发明专利已经入实质审查阶段，该方法通过确定叠层结构、内层线路制作、盖板制作、盖板锣槽、压合、外层线路、揭盖锣槽和电金手指等步骤制作阶梯结构金手指。
	高精密机械控深钻微盲	ZL201920236203.9	自主研发	样板和批量板	公司高精密机械控深钻微盲孔工艺，主要解决了利用机械钻孔设备即可实现 PCB 微盲孔工艺，降低了对激光钻孔设备的依赖，改善

技术类别	核心技术名称	专利号/专有技术	技术来源	应用情况	核心技术特点
	孔工艺				高密度互连板激光钻孔后孔形差、除胶困难等问题，以满足表面安装技术（SMT）用 PCB 的需求。

（四）研发水平

公司是高新技术企业、宝安区自主创新型优势科技企业，是香港理工大学、东南大学和南京航空航天大学产学研基地，也是广东省科学技术厅认定的“高密度多层 PCB 绿色制造广东省工厂技术研究中心”。同时，公司的全资子公司江西强达是高新技术企业和江西省“专精特新”中小企业。

公司创始团队成员来自于深南电路、崇达技术等 PCB 行业内优质的上市公司，具有二十年以上 PCB 产品的研发、设计、生产、销售和管理经验。经过数年发展，公司已拥有一支经验丰富和长期稳定的专业人才团队，在 PCB 领域积淀了深厚的技术和经验。

公司 PCB 产品“77GHz 毫米波雷达板关键技术研发及产业化”科技成果经由清华大学深圳国际研究生院、哈尔滨工业大学（深圳）和深圳大学等专家评价鉴定，认为该项目技术拥有自主知识产权，整体达到国内领先水平。

截至本上市保荐书签署日，公司拥有专利 73 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 66 项。

截至本上市保荐书签署日，公司在研项目如下：

序号	项目名称	相应人员	经费预算 (万元)	研发目标	研发进度
1	刚柔结合 FPC 埋孔印制板技术的研究	谢洪涛等 12 人	100.00	开发完整的“刚柔结合 FPC 埋孔印制板”的产品测试和 PCB 制造工艺规范	中试试验
2	高速混压 HDI 板制备技术的研究	袁秋怀等 18 人	200.00	改善高速板料激光钻孔技术，激光孔底残胶清除方法，完善聚苯乙烯材料表面金属化的控制方法等	中试试验
3	填孔电镀技术研究	梁展南等 4 人	70.00	填孔电镀凹点控制 $\pm 15 \mu\text{m}$ ，激光盲孔厚径比 1:1，增加对微盲孔采用等离子体清洗，等离子体可以将钻孔后所残留的碳黑清洁干净	中试试验
4	孔径 1.5mm 以上孔壁粗糙度改善研究	陶熔等 4 人	70.00	钻孔孔壁粗糙度 $\leq 25 \mu\text{m}$ 的工艺流程设计，增加对微盲孔采用等离子体清洗，等离	中试试验

序号	项目名称	相应人员	经费预算 (万元)	研发目标	研发进度
				子体可以将钻孔后所残留的碳黑清洁干净，减少回流焊后盲孔脱垫	
5	埋阻板加工技术的研究	甘剑军等 4人	50.00	采用 LDI 曝光+酸性真空蚀刻+碱性蚀刻，电阻层宽度控制在 $\pm 15 \mu\text{m}$ ，恒温恒湿环境测量电阻阻值，利用 PCB 双面的铜箔，降低基材厚度，提高介电常数组成需要的电容器等	研发方案
6	邦定台阶板加工技术的研究	陈素珍等 4人	50.00	台阶压合对位技术，多次压合涨缩技术，台阶位置邦定 PAD 局部电金技术，激光切割技术，切割防碳化技术	研发方案
7	400G 光模块印制板研发	余天鹏等 14人	240.00	改进和完善高速 HDI 压合制作工艺，高速板料激光钻孔技术，激光孔底残胶清除方法研究，高速 HDI 表面金属化及铜箔结合力的控制方法	中试试验
8	77G 毫米波雷达 HDI 印制板研制	万应琪等 22人	533.00	改进和完善局部薄铜工艺，通过采用积分补偿控制天线阵子方配圈直角度 RA 小于 $10\mu\text{m}$ ，使用 PTFE 材料激光钻孔工艺，开发完整的毫米波雷达印制板局部薄铜制造工艺。	样品制作
9	高精密 6 阶任意互联 HDI 印制板技术的研究	叶圣云等 18人	400.00	对正反双面进行蚀刻以保证两面蚀刻线路的稳定性，利用 DI 机制作线路，同时干膜采用高解析度厚干膜，采用 OE 方法实现对机械钻孔参数的制定，控制次压合层间对准度，改进和完善高精密 6 阶任意互连 HDI 印制板的 PCB 制造工艺规范。	样品制作
10	高频混压 HDI 印制板技术的研究	王记雄等 16人	333.00	采用高频 HDI 压合制作工艺、高频覆铜板激光钻孔工艺、激光孔底残胶清除方法、高频 HDI 表面金属化及铜箔结合工艺等制作工艺，改进	样品制作

序号	项目名称	相应人员	经费预算 (万元)	研发目标	研发进度
				和完善高频混压 HDI 印制板工艺技术。	
11	激光器用 DPC 陶瓷电路板技术研究	杨鸿辉等 10 人	240.00	陶瓷片使用夹具镀铜工艺，改进陶瓷片表面金属化及铜箔结合力控制方法，形成激光器用 DPC 陶瓷电路板工艺技术。	样品制作
12	高速光模块 HDI 板的技术研究	高瑞等 18 人	600.00	改善金手指三面包金技术开发，形成高速光模块 HDI 板工艺技术规范，在有条件的情况下，公开发表期刊论文，形成专有技术或申请专利。	样品制作
13	mini-LED 显示屏用 HDI 板的技术研究	杜建云等 18 人	600.00	采用 DI 机对位确保图形对位精度，同时压合采用融合加铆合以提高层压对准度，多次压合层间对准度控制，使用哑光杂色油零缺陷控制工艺技术，电镀填孔过程中将凹陷度控制在 $\pm 20\mu\text{m}$ 以内，研究开发 mini-LED 显示屏用 HDI 板工艺技术，形成相应的专有技术或专利。	样品制作
14	5G 高速通信印制板的技术研究	廖魏等 15 人	480.00	针对新高速材料形成台阶板工程设计方案，研究开发使用低流量聚乙烯材料层压时台阶位置金属配圈的保护，完善 5G 高速通信用印制板工艺技术规范，丰富公司的产品线。	样品制作

（五）主要经营和财务数据及指标

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司最近三年一期的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1、主要财务数据

(1) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产	37,091.38	36,536.21	21,928.57	18,950.64
非流动资产	32,234.06	28,433.85	22,775.96	20,683.13
资产总计	69,325.44	64,970.06	44,704.52	39,633.76
流动负债	27,220.52	26,886.58	20,300.51	19,361.86
非流动负债	6,429.44	6,231.19	10,229.33	9,061.36
负债合计	33,649.95	33,117.77	30,529.84	28,423.22
归属于母公司股东权益	35,675.49	31,852.29	14,174.68	11,210.54
所有者权益合计	35,675.49	31,852.29	14,174.68	11,210.54
负债和所有者权益总计	69,325.44	64,970.06	44,704.52	39,633.76

(2) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	35,809.66	71,032.45	49,949.55	39,934.39
营业利润	3,779.85	7,275.25	2,992.17	1,057.00
利润总额	3,804.82	7,455.36	3,042.43	1,061.76
净利润	3,492.98	6,806.91	2,784.66	1,021.36
归属于母公司股东的净利润	3,492.98	6,806.91	2,784.66	1,021.36
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	3,299.47	6,395.71	2,262.42	508.17

(3) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,451.80	10,432.56	5,065.83	1,679.79
投资活动产生的现金流量净额	-3,721.85	-3,720.77	-3,039.29	-2,513.62
筹资活动产生的现金流量净额	-98.50	1,652.49	-1,434.92	1,100.42
现金及现金等价物净增加额	-268.61	8,320.16	457.03	308.74

2、主要财务指标

项目	2022 年 6 月 30 日 /2022 年 1-6 月	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度
流动比率（倍）	1.36	1.36	1.08	0.98
速动比率（倍）	1.19	1.16	0.90	0.84
资产负债率（合并）	48.54%	50.97%	68.29%	71.71%
资产负债率（母公司）	37.63%	40.50%	44.19%	49.25%
应收账款周转率（次/年）	1.84	4.27	3.69	3.36

项目	2022年6月30日 /2022年1-6月	2021年12月31日 /2021年度	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度
存货周转率（次/年）	4.99	11.05	11.28	10.00
息税折旧摊销前利润（万元）	5,767.86	10,315.54	5,108.67	2,907.00
利息保障倍数	15.29	14.65	15.40	7.61
归属于母公司所有者的净利润（万元）	3,492.98	6,806.91	2,784.66	1,021.36
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润（万元）	3,299.47	6,395.71	2,262.42	508.17
研发投入占营业收入的比例	6.02%	5.57%	6.10%	5.77%
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.61	1.85	1.00	0.33
每股净现金流量（元/股）	-0.05	1.47	0.09	0.06
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	6.31	5.63	2.80	2.21

（六）发行人存在的主要风险

1、市场竞争加剧的风险

全球 PCB 行业竞争格局较为分散，生产厂商众多，市场竞争充分。随着近年来行业内领先的国内印制电路板企业纷纷建厂扩产，大型的印制电路板企业在批量板的竞争优势可能将愈发凸显，未来市场竞争可能加剧，导致行业加速洗牌，行业集中度逐步提升。公司专注于中高端样板和小批量板市场，与行业龙头企业相比，公司在业务规模、市场占有率等方面存在一定的差距，若公司未能持续提高技术水平、生产管理能力和产品质量以应对市场竞争，则存在因市场竞争加剧导致盈利下滑的风险。

2、经营业绩波动的风险

报告期内，公司主营业务收入分别为 39,189.14 万元、49,127.41 万元、69,117.72 万元和 34,393.30 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 508.17 万元、2,262.42 万元、6,395.71 万元和 3,299.47 万元，公司业绩规模增长较快。

公司主营业务为 PCB 的研发、生产和销售，专注于中高端样板和小批量板业务，报告期内服务的活跃客户近 3,000 家。公司销售区域存在境内销售和境外销售，其中内销客户集中度较低，外销客户主要是专业的 PCB 贸易商，集中度

相对较高。公司内销业务中，个别客户的流失对公司经营产生的影响较小，但若未来 PCB 市场需求整体放缓，将对公司内销收入造成不利影响；公司外销业务中，PCB 贸易商集中度相对较高，若未来公司与主要外销 PCB 贸易客户的合作模式发生变化或未达预期，将对公司外销收入造成不利影响。

若未来 PCB 市场需求放缓、境内外客户合作模式发生变化或未达预期，以及产品价格和原材料价格发生重大不利变化，将对公司整体经营业绩造成不利影响。

3、主要原材料价格波动的风险

公司 PCB 产品的主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜球和铜箔等。受上游金属铜、树脂和玻璃纤维的价格快速增长影响，2021 年公司主要原材料覆铜板、半固化片、铜球和铜箔的采购均价分别较 2020 年增长了 31.52%、32.12%、38.70%和 44.84%。若未来公司主要原材料采购均价因宏观经济波动、产业供需情况影响发生波动，将对公司经营业绩造成不利影响。

报告期内，公司直接材料成本占比分别为 46.44%、46.03%、53.38%和 53.93%，其中覆铜板、铜箔、铜球等含铜材料成本占直接材料的比例较高，含铜材料成本占直接材料的比例在 62.55%-67.22%之间，公司主要原材料价格波动，尤其是含铜材料价格波动对公司产品生产成本影响较大。公司采购覆铜板、铜箔、铜球等含铜材料与铜价呈正相关关系，故公司主要原材料价格波动和铜价波动将对公司主营业务成本产生影响，进而影响公司毛利率。

2020 年 4 月以来，铜价触底反弹，尤其是 2020 年末至 2021 年上半年铜价持续大幅上涨，此后 2021 年下半年至 2022 年 6 月持续在高位震荡，2022 年 6 月中下旬至 7 月铜价大幅下跌后又快速回调。2020-2021 年，公司主要原材料价格，尤其是覆铜板、铜箔、铜球等含铜材料价格上涨，2022 年 6 月以来含铜材料价格有所下滑。根据测算，假设其他条件不变，若公司主要原材料价格分别上涨 10%和 20%，报告期内公司主营业务毛利率下降幅度分别在 3.43-4.00 个百分点之间和 6.86-8.01 个百分点之间；若公司主要原材料中含铜材料价格分别上涨 10%和 20%，报告期内公司主营业务毛利率下降幅度分别在 2.14-2.61 个百分点之间和 4.29-5.22 个百分点之间。因此，若公司覆铜板、铜箔、铜球等主要含铜

材料价格受铜价影响而大幅波动，公司亦未能合理调整报价基准，顺畅地将原材料价格上涨的压力传导至下游客户或未能通过工艺优化、提升生产水平等抵消成本上涨的压力，导致价格传导速度及提价幅度不及原材料上涨幅度，又或者客户在铜价下跌时要求公司下调价格，公司主营业务毛利率以及盈利情况存在快速下滑的风险。

4、公司收入可能无法维持高速增长的风险

报告期内，公司主营业务收入分别为 39,189.14 万元、49,127.41 万元、69,117.72 万元和 34,393.30 万元，其中 2020-2021 年及 2022 年 1-6 月分别较上一年度同期增长 25.36%、40.69%和 3.47%。报告期内，公司经历了 2019-2021 年收入高速增长阶段，2022 年以来，受宏观经济波动和新冠疫情反复等多方面因素的影响，PCB 市场增速减缓、在手订单趋于平稳增长、公司产能利用率短暂回落，导致 2022 年全年公司预计收入增长但增速较 2020-2021 年有所减缓。未来，若 PCB 市场增速持续减缓，主要客户需求下降，公司在手订单及产能利用率下降，公司存在可能无法维持高速增长的风险。

5、新冠疫情导致的风险

新冠疫情仍未在全球得到全面控制，海外疫情的持续蔓延给国内带来输入性风险，造成国内疫情反复。国内部分地区因疫情而导致生产、运输受到诸多不利影响，若疫情长期无法得到有效控制，则会对公司的生产经营造成不利影响。

公司内销的下游客户主要为电子产品制造商等终端用户，若国内疫情反复，公司下游客户可能因受疫情影响而无法保障持续稳定生产，从而导致订单推迟执行或无法执行，对公司的经营业绩造成不利影响。公司外销收入占比较高，若海外疫情持续无法得到有效控制，全球疫情的蔓延也可能对航运、贸易带来一定不利影响，从而导致出口业务的需求或价格受到影响，对公司经营业绩造成不利影响。

6、宏观经济波动的风险

PCB 作为电子产品和信息基础设施不可缺少的基础电子元器件，公司所处 PCB 行业下游应用涉及工业控制、通信设备、汽车电子、医疗健康和半导体测

试等多个领域，PCB 行业与宏观经济形势密切相关。

由于目前全球受贸易摩擦、地缘政治和新冠疫情等因素影响，国内外宏观经济形势可能存在不稳定的情况。若未来宏观经济发生波动，PCB 市场产值增长速度可能存在放缓或下滑的风险，对公司经营业绩造成不利影响。

7、中美贸易摩擦的风险

报告期内，公司外销收入分别为 16,327.71 万元、19,411.81 万元、28,243.60 万元和 14,276.57 万元，分别占当期主营业务收入 41.66%、39.51%、40.86%和 41.51%。

2018 年以来中美贸易摩擦加剧，美国对产自中国的包括 PCB 产品在内的多项电子产品加征关税。若未来美国贸易保护主义政策持续趋严，可能对全球经济和产业链竞争格局带来冲击，对公司所处 PCB 行业造成不利影响。

8、技术创新无法满足下游需求的风险

公司专注于中高端样板和小批量板产品，致力于满足客户在研究、开发、试验和小批量阶段对 PCB 的专业需求，产品广泛应用于工业控制、通信设备、汽车电子、消费电子、医疗健康和半导体测试等领域。公司订单呈现“多品种、小批量、高品质、快速交付”的需求特点。尽管公司具备研发和技术创新能力，但若未来下游客户的需求发生重大变化，而公司亦未及时保持技术创新，存在无法持续满足下游需求的风险。

9、业务规模扩大导致的管理风险

本次发行股票并上市后，随着本次募投项目的建成达产，公司的产能也将大幅提升。公司经营规模、产品型号、客户数量和应用领域将不断扩大，以及在深圳、江西和南通等不同的生产基地同时开展生产，对公司采购、市场开拓、生产、研发、资源整合和持续创新等方面的管理体系、管理水平和人员素质都提出了更高的要求。

PCB 产品生产涉及的工序众多、工艺流程相对复杂、产品种类繁多和参数多变，随着公司业务规模的提高将加大对经营决策和柔性化管理等方面的难度。若公司不能保持目前在交期、对客户需求快速响应的能力以及在柔性化管理等方

面的优势，可能会出现服务能力下降、交期延长和成本上升等的风险，公司将面临老客户流失、新客户开拓和新增产能消化的风险，从而对公司生产经营产生不利影响。

10、环保的风险

PCB 产品的生产过程中，会产生废水、废气及固体废弃物。如果公司的环保治理、“三废”排放不能满足监管要求，将可能导致公司受到罚款、停限产等监管措施，从而对公司的生产经营造成不利影响。此外，国家及地方政府可能在将来颁布更严格的环境保护法律法规，提高环保标准，公司可能需要进一步增加环保投入以满足监管部门对环保的要求，将导致经营成本增加。

11、安全事故的风险

PCB 企业普遍在生产过程中存在生产工序长、大型机器设备多、生产员工众多的特点。随着公司业务规模的不断扩大以及相关设施、设备的老化，如不能始终严格执行各项安全管理措施，不断提高员工的安全生产能力和意识，及时维护、更新相关设施、设备，公司存在发生安全事故的风险，对员工人身及公司财产安全造成损失，对公司经营造成不利影响。

12、毛利率波动的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 21.44%、23.20%、25.44%和 23.98%，剔除运输费影响后的主营业务毛利率分别为 21.44%、25.44%、27.16%和 25.75%，其中收入占比 37.86%-42.50%之间的样板产品毛利率分别为 46.20%、46.73%、44.71%和 41.64%，样板产品的毛利率较高。

若未来公司产品结构发生变化，毛利率较高的中高端样板或特殊工艺的批量板产品收入占比下降，市场需求放缓或竞争加剧导致产品价格下降，亦或公司的核心技术、客户响应速度、工艺多样性等未能满足客户技术发展方向的需求，又或公司不能有效持续拓展客户并增加市场份额，该类产品的高毛利率不能维持现有水平或出现大幅下降，以及募投项目投产后新增产能难以及时消化，则公司主营业务毛利率存在下滑的风险。

13、应收账款发生坏账的风险

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 12,334.83 万元、14,730.53 万元、18,535.36 万元和 20,322.95 万元，占当期营业收入的比例分别为 30.89%、29.49%、26.09%和 28.38%，其中账龄一年以内应收账款余额占比由 2019 年末的 96.67%提升至 2022 年 6 月 30 日的 98.72%。若公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况和商业信用发生重大不利变化，则可能出现支付困难或发生坏账的情形，对公司的资金周转和生产经营造成不利影响。

14、存货跌价的风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 2,765.95 万元、3,563.30 万元、5,278.84 万元和 4,600.56 万元，占流动资产的比例分别为 14.60%、16.25%、14.45%和 12.40%。若未来公司主要原材料和产品价格在短期内发生大幅下降，或因国家政策和市场需求造成客户变更或取消订单计划，从而导致公司产品难以在短期内实现销售，则可能造成存货的可变现净值低于账面价值，需要计提减值准备，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

15、汇率波动的风险

报告期内，公司主营业务外销收入分别为 16,327.71 万元、19,411.81 万元、28,243.60 万元和 14,276.57 万元，其中 PCB 外销收入分别为 16,153.00 万元、19,339.84 万元、28,201.12 万元和 14,239.36 万元，占当期 PCB 主营业务收入的比重分别为 41.65%、39.46%、40.85%和 41.47%，外销收入占比比较高。报告期内，公司外销收入主要以美元定价和结算，汇兑损益分别为 32.55 万元、-193.60 万元、-178.42 万元和 348.37 万元。根据中国人民银行公布的美元兑人民币中间价，2022 年 4 月初至 11 月末美元对人民币汇率由 6.3509 增长至 7.1617，尽管目前美元兑人民币汇率仍处于高位，但汇率变化受国内外经济等多方面因素的影响，若未来汇率发生较大变化，将会引起公司以外币结算的外销收入产生变化，外汇收支相应会产生汇兑损益，汇兑损益的大幅变动可能会对公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润产生较大不利影响，进而可能会对公司经营业绩造成不利影响。

16、出口退税政策调整的风险

报告期内，公司出口业务收入占比较大，公司主要产品出口适用退税率为16%和13%。增值税属于价外税，增值税免抵退税额并不直接影响公司损益，但其中不予抵扣部分会作为增值税进项税额转出而增加企业的营业成本。如果国家对出口产品的退税率进行进一步调整，出现大幅调低公司主要产品出口退税率的情况，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

17、资产负债率较高的风险

报告期各期末，公司合并口径下的资产负债率分别为71.71%、68.29%、50.97%和48.54%，公司资产负债率逐年下降，但仍处于较高水平。公司运营资金主要源于经营所得、股东投入和机构借款等，尚未进行大额直接股权融资。随着公司经营规模增长及募投项目实施投产，对运营资金的需求将不断增加，若公司不能获得足够资金，将对公司生产经营产生不利影响，公司存在资产负债率较高的风险。

18、房屋租赁的风险

截至本上市保荐书签署日，公司租赁的位于深圳市宝安区福发工业园的主要房屋及建筑物无产权证书，无法根据产权证书确定租赁物业产权权属，存在因租赁物业权属不清无法继续使用租赁物业的风险。若未来该等租赁地块因土地整备计划或城市更新计划被收回，或者房屋被政府部门依法责令拆除、改变用途等，将可能导致公司产生停工、搬迁等损失，进而对公司生产经营产生不利影响。

19、募集资金投资项目实施的风险

本次募集资金投资项目的成功实施需要结合经济形势、产业政策、市场环境、行业竞争态势、技术发展等外部条件与公司自身的生产经营、组织管理、市场营销的执行能力。如果上述因素发生重大不利变化，则存在募集资金不能足额到位，或项目管理、建设工期、设备安装调试、量产达标以及市场开发等方面不达预期的风险，进而影响项目的投资回报和预期收益。

20、项目投产后的产能消化风险

公司本次募投项目‘南通强达电路科技有限公司年产96万平方米多层板、HDI板项目’建成投产后，公司将新增年产96万平方米多层板、HDI板产能，届

时 PCB 产能将大幅提高，同时新增产能为中高端产品，产品定位、区域市场、客户需求、市场竞争等方面均与目前情况有较大差异。若未来 PCB 市场增长承压，PCB 市场增速大幅下滑甚至出现负增长，产品市场需求变化以及行业竞争程度加剧，或者公司技术研发能力下降、新客户开拓及订单数量增长不及预期、公司竞争优势下降等，给公司发展带来不利因素影响，公司募投项目新增产能存在难以及时消化或产能过剩的风险，可能会对项目投资回报和公司预期收益产生不利影响。

21、固定资产折旧增加的风险

本次募集资金投资项目完工后，新增固定资产及相应折旧费用将增加。若市场出现重大不利变化，募集资金投资项目建成后不能尽快达产或未能实现预期收益以消化新增的折旧费用，则公司存在因固定资产折旧费用增加而导致利润下滑的风险。

22、即期回报被摊薄的风险

本次募集资金到位后，公司股本和净资产将大幅增加。由于募集资金投资项目的实施和达产需要一定的建设周期，项目产生收益尚需一段时间，公司在本次发行完成后，存在短期内即期回报被摊薄（每股收益、净资产收益率下降）的风险。

23、监管审核及发行失败风险

公司本次拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，尚需满足多项条件方可实施，本次发行能否通过审核并实施注册存在不确定性。本次发行的发行结果可能受到证券市场整体情况、公司经营业绩、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素影响，公司存在因发行认购不足导致发行中止甚至发行失败的风险。

二、本次发行情况

（一）本次发行的基本情况

股票种类	人民币普通股（A 股）
------	-------------

每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	本次公开发行股份数量不超过 1,884.40 万股股票（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），全部为发行新股，公司原股东在本次发行中不公开发售股份（最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准）；本次公开发行新股数量不低于发行后公司总股本的 25%。最终发行数量由公司股东大会授权公司董事会在上述范围内与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。
每股发行价格	【】 元
发行人高管、员工拟参与战略配售情况（如有）	【】
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况（如有）	【】
发行市盈率	【】 倍（按照每股发行价除以发行后每股收益计算）
发行后每股收益	【】 元（按【】年【】月【】日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
发行前每股净资产	【】 元（按照发行前一期经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】 元（按照本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和计算）
发行市净率	【】 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式
发行对象	符合资格的询价对象和开通创业板交易权限且符合创业板投资条件的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他对象
承销方式	余额包销
发行费用概算	（1）保荐及承销费用【】万元 （2）审计及验资费用【】万元 （3）评估费用【】万元 （4）律师费用【】万元 （5）发行手续费用及其他费用【】万元

（二）本次发行上市的重要日期

刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

三、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

（一）保荐机构名称

招商证券股份有限公司。

（二）保荐代表人主要保荐业务执业情况

招商证券指定吴茂林、刁雅菲为深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人。

1、招商证券吴茂林主要保荐业务执业情况如下：

项目名称	保荐工作	是否处于持续督导期间
湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票项目	保荐代表人	是
深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目	保荐代表人	是
长春燃气股份有限公司非公开发行股票项目	保荐代表人	否
深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行股票项目	保荐代表人	否
金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行股票项目	保荐代表人	否

2、招商证券刁雅菲主要保荐业务执业情况如下：

项目名称	保荐工作	是否处于持续督导期间
湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票项目	保荐代表人	是
深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目	项目组成员	是

吴茂林、刁雅菲在保荐业务执业过程中，能严格遵守《保荐管理办法》等相关法律法规，诚实守信、勤勉尽责地履行相关义务；定期参加中国证券业协会组织的保荐代表人年度业务培训；执业记录良好。

截至本上市保荐书签署之日，吴茂林、刁雅菲符合可以在主板（含中小企业板）和创业板同时各负责两家在审企业的规定，除本项目外，吴茂林还担任湖南海利化工股份有限公司（600731.SH）非公开发行股票项目的签字保荐代表人，符合《关于进一步加强保荐业务监管有关问题的意见》第六条的规定。

（三）项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：鲁帆

项目组其他成员：林煜佳、雷亚中、刘畅之、连亚峰、赵心宇

四、保荐机构与发行人之间的关联关系

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

截至本上市保荐书签署之日，本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

截至本上市保荐书签署之日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方的股份（通过二级市场买卖招商证券及其重要关联方股票的情况除外），不存在影响本保荐机构和保荐代表人公正履行保荐职责的情况。

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况

截至本上市保荐书签署之日，本保荐机构的保荐代表人及其配偶，本保荐机构的董事、监事、高级管理人员均不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况。

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

截至本上市保荐书签署之日，本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系

除上述说明外，本保荐机构与发行人不存在其他需要说明的关联关系。

五、保荐机构的承诺

本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，做出如下承诺：

（一）已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序，同意推荐发行人本次证券发行上市，并具备相应的保荐工作底稿支持。

（二）根据《保荐管理办法》第二十六条：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监

管措施；

9、中国证监会规定的其他事项；

本保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所对推荐证券上市的规定，接受深圳证券交易所的自律监管。

六、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所规定的决策程序

（一）发行人董事会对本次证券发行上市的批准

2022年4月14日，发行人依法召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。

（二）发行人股东大会对本次证券发行上市的批准、授权

2022年4月30日，发行人依法召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》、《关于授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。

综上，本保荐机构认为发行人就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会、深交所规定的决策程序。

七、保荐机构关于发行人符合创业板上市条件的说明

（一）发行人符合《注册管理办法》有关规定

1、符合第十条相关发行条件

根据《发起人协议》、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2021]6055号《审计报告》、发行人历次股东大会、董事会会议决议、发行人现行有效的《公司章程》、发行人律师广东信达律师事务所出具的《法律意见书》、《企业法人营业执照》等文件和本保荐机构的核查，发行人的前身深圳市强达电

路有限公司设立于 2004 年 5 月 31 日，于 2021 年 7 月 27 日依法整体变更为股份有限公司，发行人系依法设立并持续经营三年以上的股份有限公司。

根据发行人《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬和考核委员会工作制度》、《战略委员会工作制度》、内部控制制度、历次“三会”会议通知、会议决议、会议纪要等文件及本保荐机构的核查，发行人已依法建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等公司治理体系。发行人目前有 6 名董事，其中 2 名为公司选任的独立董事；董事会下设 4 个专门委员会即：审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会和战略委员会；发行人设 3 名监事，其中 2 名是由股东代表选任的监事，1 名是由职工代表选任的监事。

根据本保荐机构的核查以及发行人的说明、发行人审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2022]6823 号《内部控制鉴证报告》、发行人律师广东信达律师事务所出具的《法律意见书》，发行人设立以来，股东大会、董事会、监事会能够依法召开，规范运作；股东大会、董事会、监事会决议能够得到有效执行；重大决策制度的制定和变更符合法定程序。

经核查，本保荐机构认为：发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条的规定。

2、符合第十一条相关发行条件

根据查阅和分析中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2022]6822 号《审计报告》和中汇会鉴[2022]6823 号《内部控制鉴证报告》、发行人的重要会计科目明细帐、重大合同、财务制度、经主管税务机关确认的纳税资料、关联交易的会议记录、同行业公司经营情况、内部控制制度及其执行情况、发行人的书面说明或承诺等文件和本保荐机构的核查，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师

出具无保留意见的审计报告。发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《注册管理办法》第十一条的规定。

3、符合第十二条相关发行条件

1、经核查发行人业务经营情况、主要资产、专利、商标等资料，实地核查有关情况，并结合实际控制人调查表及对发行人董事、监事和高级管理人员的访谈等资料。保荐机构认为，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

2、经核查发行人报告期内的主营业务收入构成、重大销售合同及主要客户等资料，发行人最近二年内主营业务未发生重大不利变化；经过对发行人历次股东大会、董事会决议资料、工商登记资料等文件的核查，本保荐机构认为发行人最近二年内董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大变化，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近二年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

3、经核查发行人财产清单、主要资产的权属证明文件等资料，结合与发行人管理层的访谈、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2022]6822号《审计报告》和发行人律师出具的法律意见书，保荐机构认为，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

综上，本保荐机构认为：发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，发行人符合《注册管理办法》第十二条的规定。

4、符合第十三条相关发行条件

保荐机构查阅了发行人的《营业执照》、主要业务合同、所在行业管理体制和行业政策，取得的工商、税务、环保、海关、技术监督等方面的主管机构出具的有关证明文件，进行公开信息查询，并与发行人主要股东、实际控制人、董事、

监事、高级管理人员进行访谈并获取其出具的声明与承诺，以及控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员的无犯罪记录证明及境外律师所出具的尽职调查报告。

经核查，保荐机构认为：发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策；最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。发行人符合《注册管理办法》第十三条的规定。

（二）发行人符合《创业板上市规则》有关规定

1、如本节之“（一）发行人符合《注册管理办法》有关规定”所述，发行人符合中国证监会、深交所规定的发行条件，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条的第（一）项条件。

2、根据本次发行股东大会决议，发行人本次发行前的股本总额为人民币 5,653.18 万元，本次拟公开发行 1,884.40 万股，发行后股本总额不低于 3,000 万元，公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条的第（二）、（三）项条件。

3、根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2022]6822 号《审计报告》，发行人 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月的归属于母公司股东净利润（取扣除非经常性损益前后较低者）分别为人民币 508.17 万元、人民币 2,262.42 万元、人民币 6,395.71 万元和人民币 3,299.47 万元。根据《创业板上市规则》，发行人选择的具体上市标准为“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条的第（四）项条件。

4、发行人符合深交所规定的其他上市条件，符合《股票上市规则》2.1.1 条

第（五）项的规定。

综上，本保荐机构认为：发行人符合《创业板上市规则》规定的上市条件。

八、对公司持续督导期间的工作安排

事项	工作计划
（一）持续督导事项	
1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其它关联方违规占用公司资源的制度。	根据相关法律法规，协助公司制订、完善有关制度，并督导其执行。
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度。	根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，协助发行人制订有关制度并督导其实施。
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见。	督导发行人的关联交易按照相关法律法规和《公司章程》等规定执行，对重大的关联交易，本保荐机构将按照公平、独立的原则发表意见。发行人因关联交易事项召开董事会、股东大会，应事先通知本保荐机构，本保荐机构可派保荐代表人与会并提出意见和建议。
4、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项。	督导发行人执行已制定的《募集资金管理制度》等制度，保证募集资金的安全性和专用性。持续关注发行人募集资金的专户储存、投资项目的实施等承诺事项。定期跟踪了解投资项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东大会，对公司募集资金投资项目的实施、变更发表意见。
5、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见。	督导发行人遵守《公司章程》及《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定。
6、督促发行人建立和执行信息披露、规范运作、承诺履行、分红回报等制度。	督导发行人进一步完善已有的信息披露、规范运作、承诺履行、分红回报等制度，督导发行人严格依照相关制度实施。与发行人建立经常性沟通机制，及时了解发行人的重大事项，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
7、识别并督促发行人披露对公司持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项，并发表意见。	与发行人建立日常沟通机制，及时了解发行人的经营过程中的重大事项，持续关注对发行人持续经营能力、核心竞争力以及控制权稳定有

事项	工作计划
	重大不利影响的风险或者负面事项，并对相关风险或负面事项及时发表意见。
8、关注发行人股票交易异常波动情况，督促发行人按照深交所规定履行核查、信息披露等义务。	实时关注发行人股票交易异常波动情况，督促发行人履行核查、信息披露等义务。
9、对发行人存在的可能严重影响公司或者投资者合法权益的事项开展专项核查，并出具现场核查报告。	与发行人建立日常沟通机制，及时了解存在的可能严重影响发行人或者投资者合法权益的事项，及时开展专项核查，并出具现场核查报告。
10、定期出具并披露持续督导跟踪报告。	与发行人建立日常沟通机制，及时了解发行人的重大事项，定期出具并披露持续督导跟踪报告。
11、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。	保荐机构、保荐代表人会针对发行人的具体情况，切实履行各项持续督导职责。
(二) 持续督导期间	发行人首次公开发行股票并在创业板上市当年剩余时间以及其后 3 个完整会计年度；持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作，本保荐机构将继续完成。
(三) 发行人应当积极配合保荐机构履行持续督导职责	发行人承诺积极配合本保荐机构履行持续督导职责，包括：及时提供履行持续督导职责必需的相关信息；发生应当披露的重大事项、出现重大风险的，及时告知保荐机构和保荐代表人；及时履行信息披露义务或者采取相应整改措施；协助保荐机构和保荐代表人披露持续督导意见；为保荐机构和保荐代表人履行持续督导职责提供其他必要的条件和便利。

九、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式

保荐机构名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系电话：0755-82943666

传真：0755-83081361

保荐代表人：吴茂林、刁雅菲

联系电话：0755-83081306

传真：0755-83081361

项目协办人：鲁帆

其他项目成员：林煜佳、雷亚中、刘畅之、连亚峰、赵心宇

十、保荐机构认为应当说明的其他事项

无。

十一、保荐机构对本次股票上市的推荐结论

本保荐机构认为：强达电路申请首次公开发行股票并在创业板上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律、法规的相关要求，其股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。招商证券同意担任强达电路本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签章页）

项目协办人

鲁 帆 签名： 鲁帆

保荐代表人

吴茂林 签名： 吴茂林

刁雅菲 签名： 刁雅菲

内核负责人

陈 鋆 签名： 陈鋆

保荐业务负责人

王治鉴 签名： 王治鉴

保荐机构法定代表人

霍 达 签名： 霍达



招商证券股份有限公司

2023年1月13日